

**平成27年3月期
(第13期)
第2四半期決算説明会**

**平成26年11月6日
株式会社ジーダット**

1. 平成27年3月期 第2四半期決算概要

2. 下期拡販戦略と今後の取り組み

3. 平成27年3月期通期予想

売上高 前年同期比:4.5%増 (計画比:9.8%減)

固定費圧縮 + 助成金収入の効果で経常利益拡大

海外向け売上高 大幅減少 前年同期比:34.8%減

製品開発比率の増大により研究開発費は減少

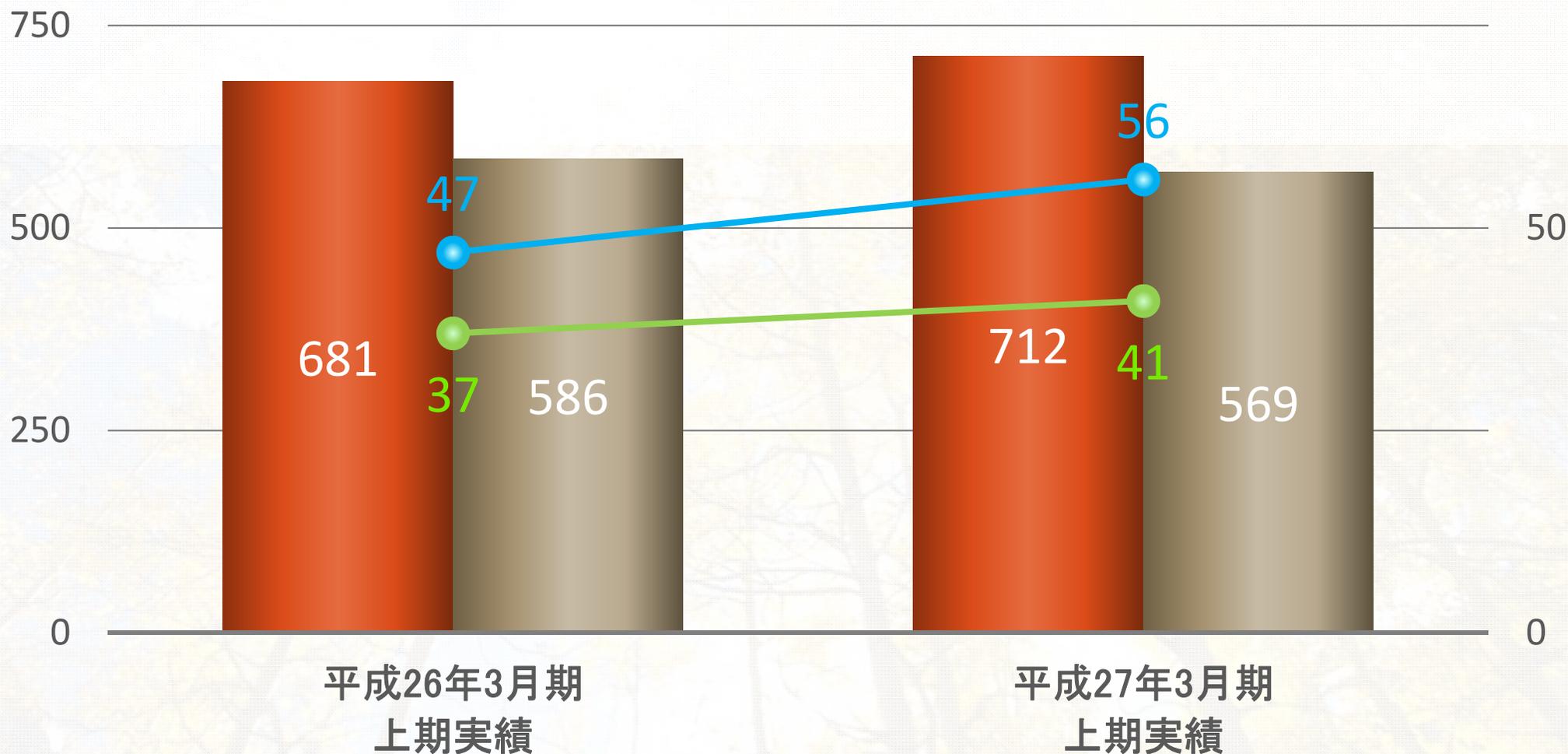
上半期実績 — 前年同期比・計画比 —

(単位:百万円)	平成26年3月期 上半期実績	平成27年3月期上半期			
		当初計画	実績	前年 同期比	計画比
売上高	681	790	712	+4.5%	△9.8%
売上総利益 (率)	552 (81.0%)	551 (69.8%)	496 (69.6%)	△10.2%	△10.1%
販売費及び 一般管理費	515	502	454	△11.8%	△9.7%
営業利益	37	48	41	+12.0%	△13.8%
経常利益	47	48	56	+19.0%	+15.3%
当期純利益	48	44	56	+16.0%	+28.9%

上半期売上高・利益 — 前年同期比 —

(単位:百万円)

■売上高 ■固定費 ●經常利益 ●営業利益



連結貸借対照表 — 前期末比 —

(単位:百万円)	平成26年 3月期末	平成26年 9月末	差異		平成26年 3月期末	平成26年 9月末	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産	2,083	2,216	132	I 流動負債	320	427	106
1 現金及び預金	1,819	1,866	46	1 買掛金	37	25	△11
2 受取手形及び売掛金	197	229	31	2 未払法人税等	18	8	△10
3 たな卸資産	28	17	△11	3 前受金	98	206	107
4 前渡金	15	70	55	4 賞与引当金	64	71	7
5 その他	23	34	10	5 その他	101	115	13
				負債合計	320	427	106
II 固定資産	562	573	10	(純資産の部)			
1 有形固定資産	23	28	4	I 株主資本	2,278	2,315	37
2 無形固定資産	19	20	1	II 評価・換算差額等	0	3	2
3 投資その他の資産合計	520	524	3	III 少数株主持分	47	43	△3
				純資産合計	2,326	2,362	36
資産合計	2,646	2,790	143	負債純資産合計	2,646	2,790	143

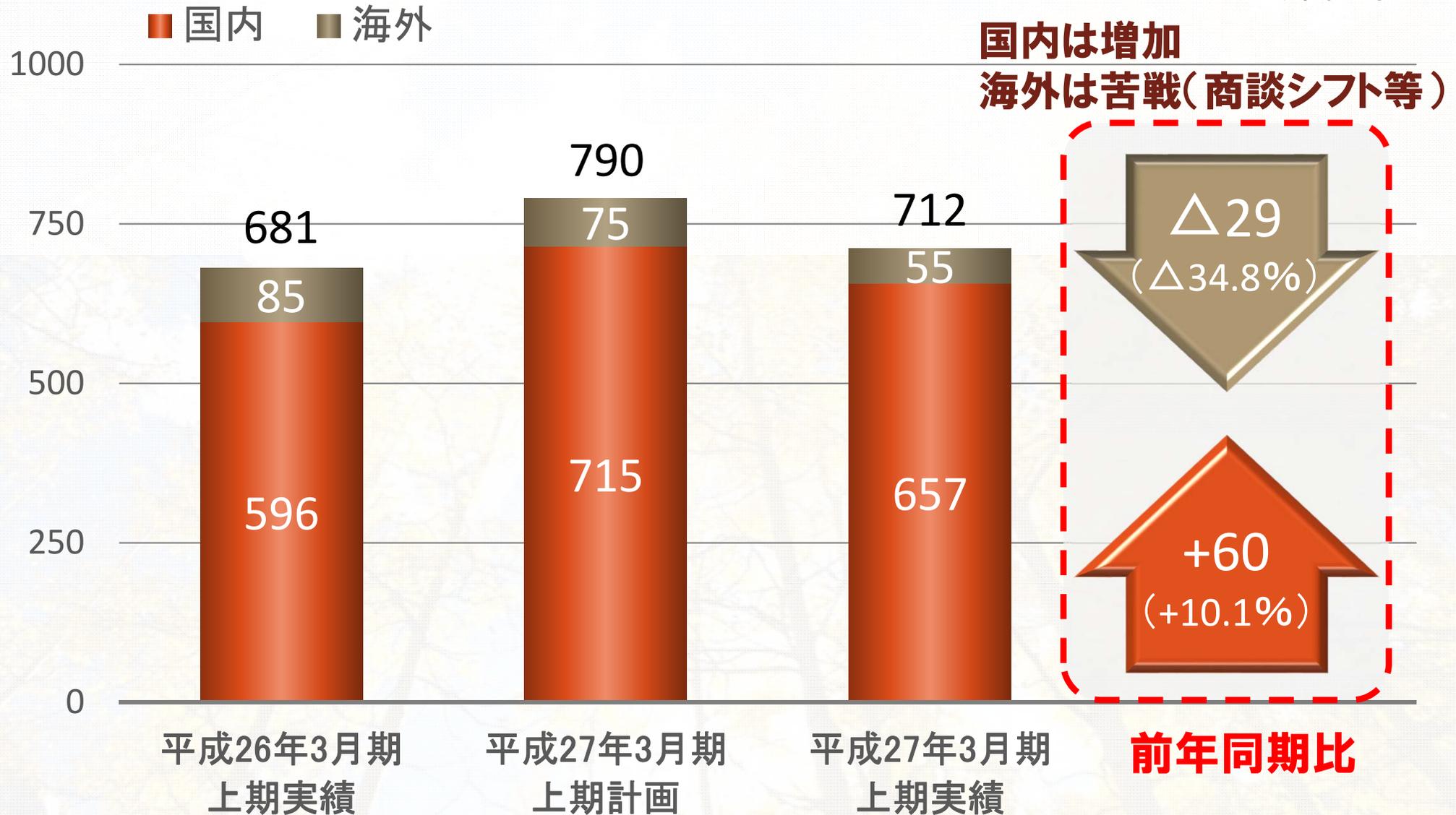
連結キャッシュフロー計算書

—前年同期比—

(単位:百万円)	平成25年4月1日 ～ 平成25年9月30日	平成26年4月1日 ～ 平成26年9月30日	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	124	80	△44
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△275	△19	256
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	46	△19	△65
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	4	4
V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△103	46	150
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,084	919	△164
VII 現金及び現金同等物の期末残高	980	966	△14

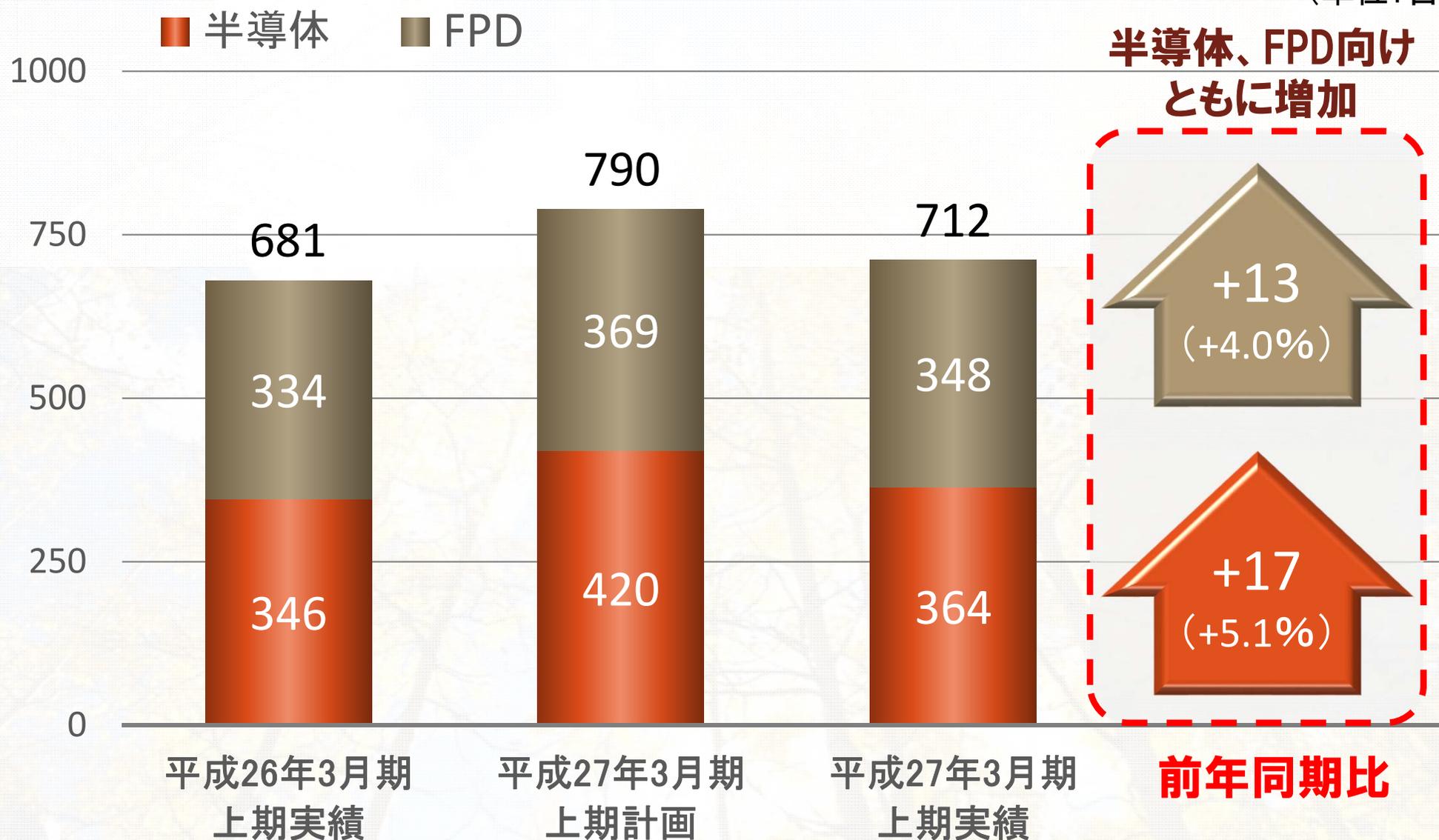
地域別売上高（国内/海外） —前年同期比—

（単位：百万円）



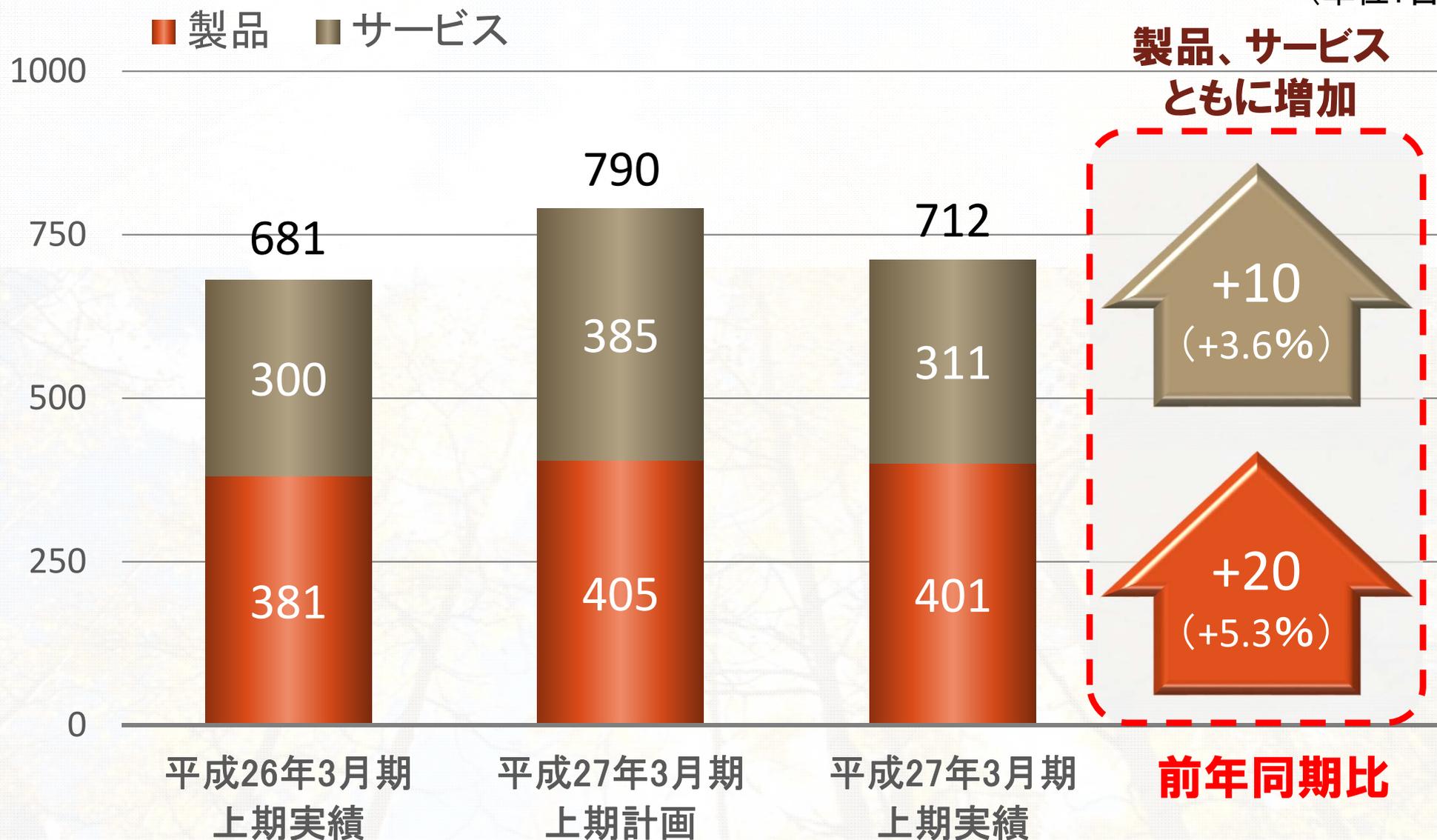
市場別売上高（半導体/FPD）－前年同期比－

(単位:百万円)



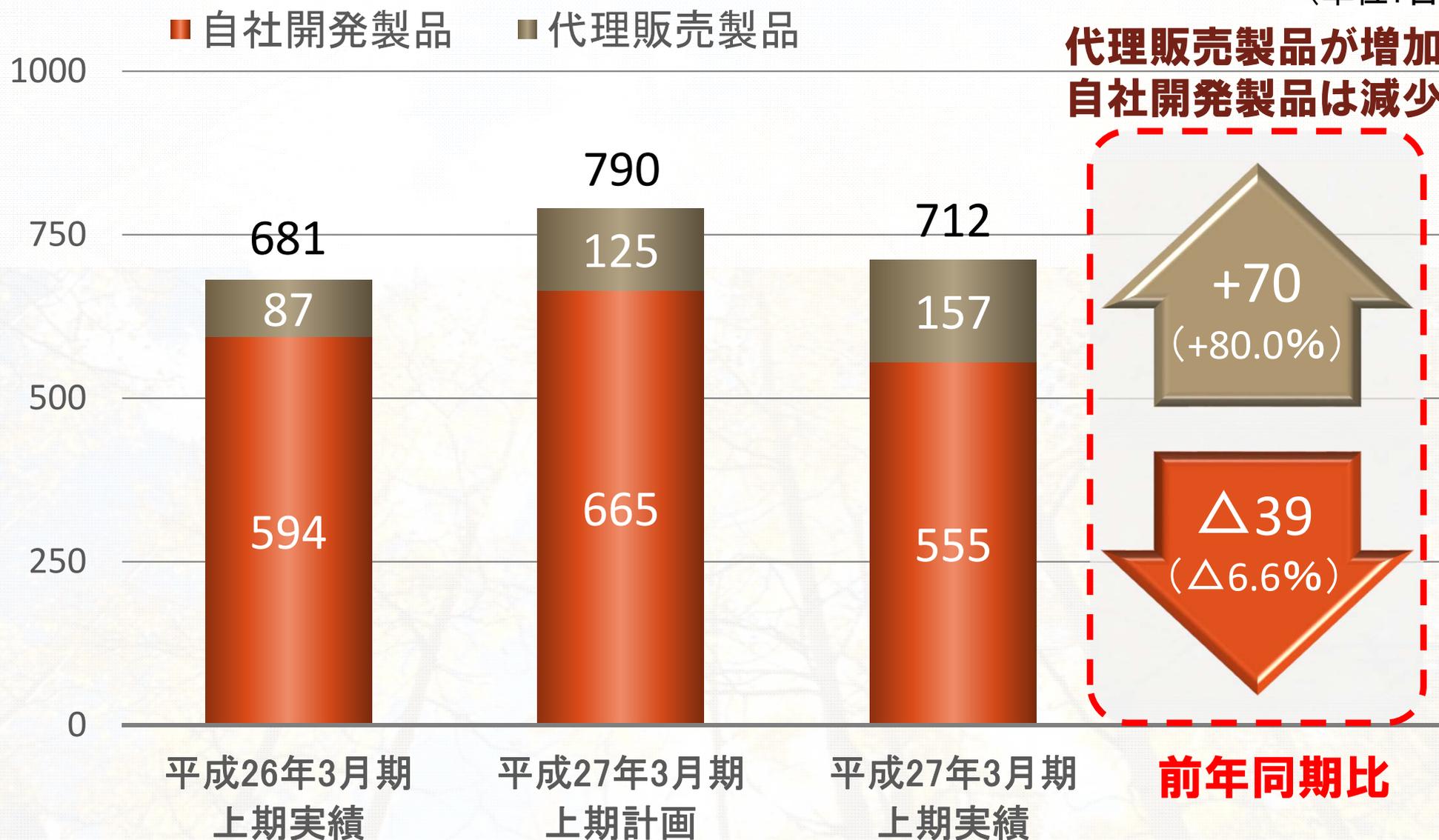
事業別売上高（製品/サービス）－前年同期比－

（単位：百万円）



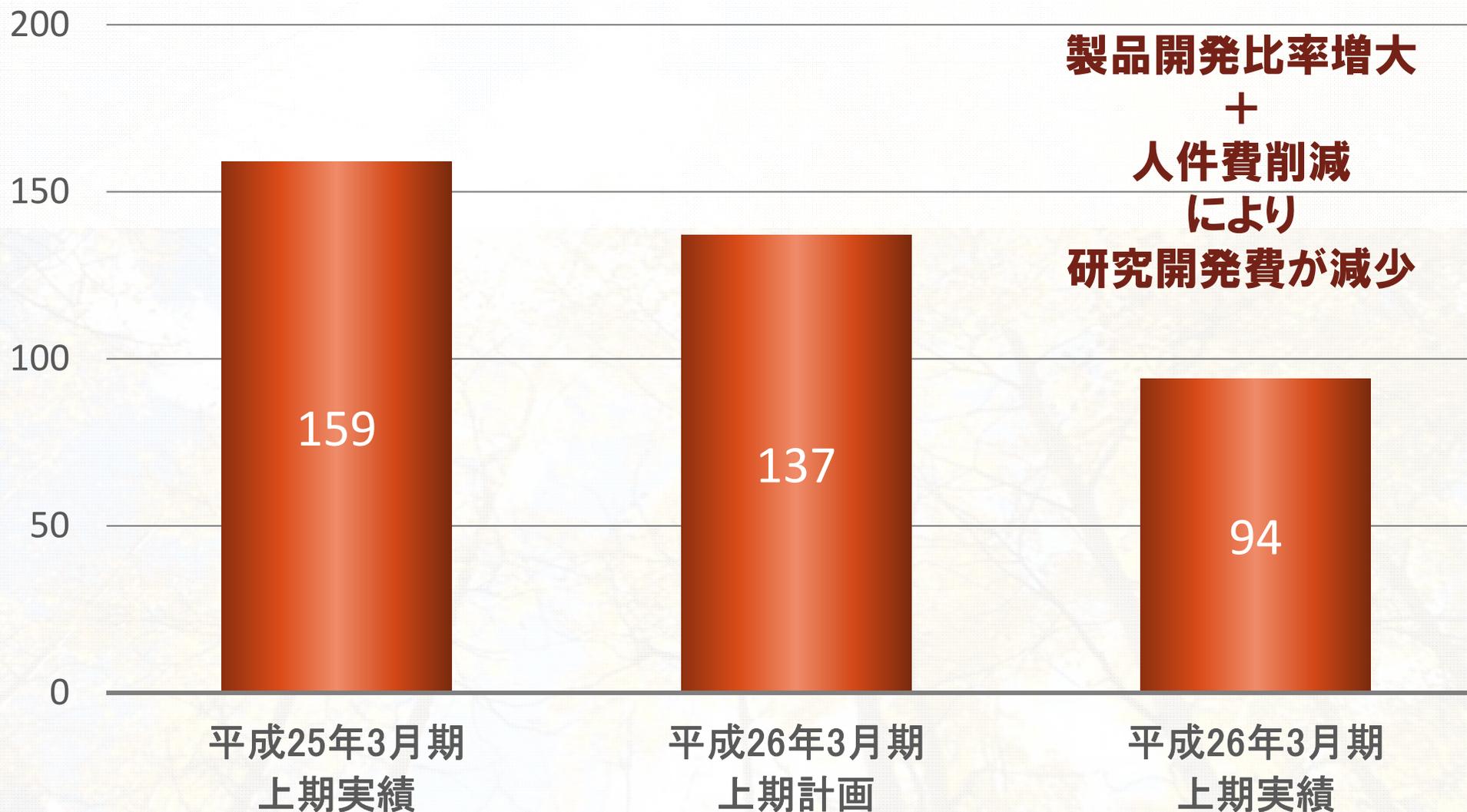
製品区分別売上高（自社開発/代理販売） —前年同期比—

（単位：百万円）



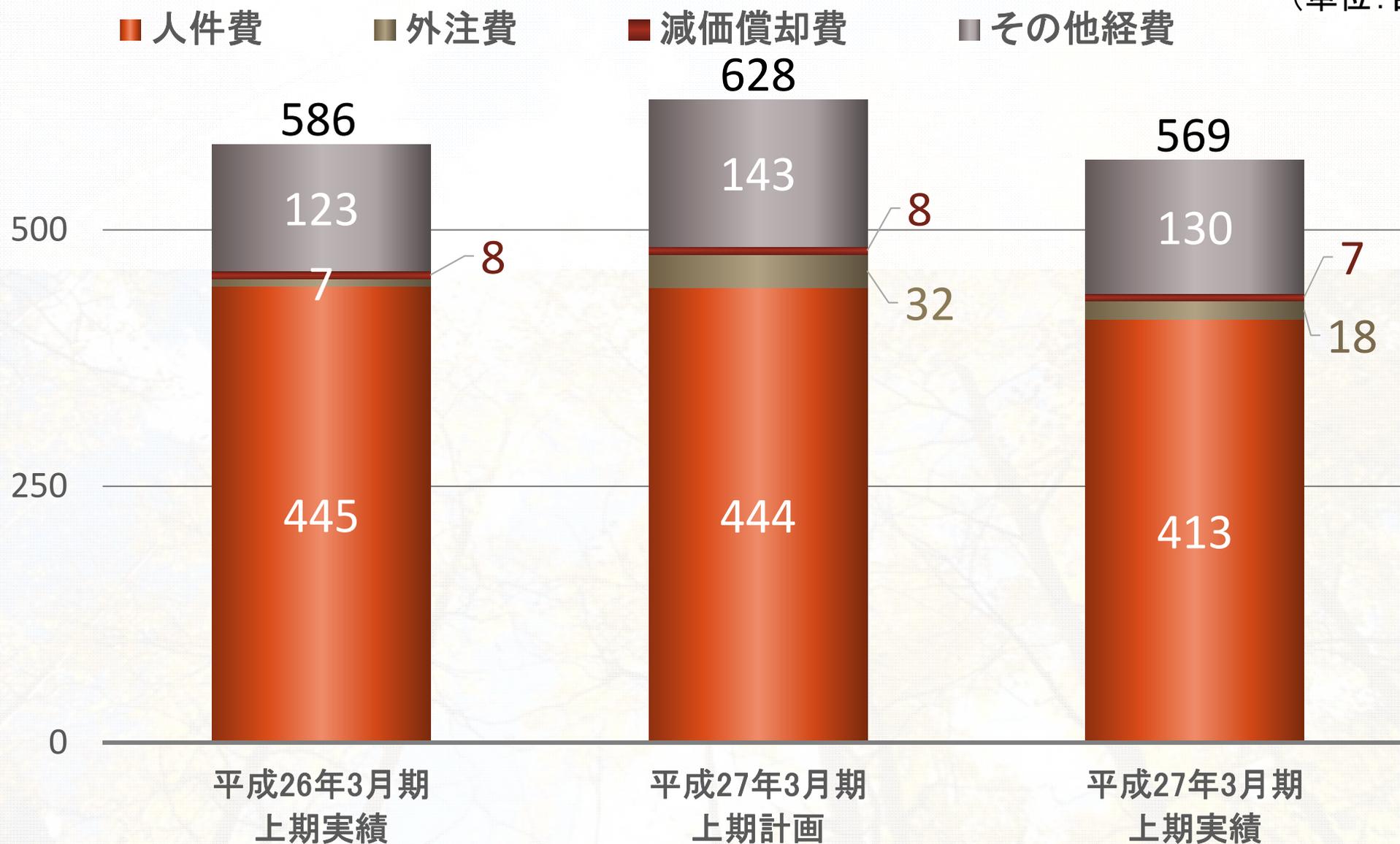
(単位:百万円)

■ 研究開発費



固定費内訳 —前年同期比—

(単位:百万円)



◆全体的には緩やかな回復基調

➤好・不調が鮮明化

◆特に：自動車・携帯機器・環境・医療関連は好調

➤パワー半導体, イメージセンサ, メモリ分野

➤タッチパネル, 高精細LCD, 有機EL分野

◆一方では：主要企業における再編・削減は進行中

◆設計需要における「ねじれ」現象発生

設計需要の増大 ↔ 設計者の減少

◆海外FPD市場



- 主要企業間の競争激化(韓国、台湾) S社vsL社, A社vsI社
- 高精細LCD、有機ELへの投資が活発(韓国、台湾)
- 投資の中心が有機EL向けに移行中(中国)

◆海外半導体市場



- 好調を維持しており市場は拡大中
- 「ファブレス」と「ファンドリ」の二極化(IDMの衰退)
- アナログ分野もプロセス微細化が進行中

◆新規代理販売製品の拡充

➤レイアウト/マスク検証系製品を投入

◆最先端アナログ設計用製品をDACで発表

➤アナログ回路・レイアウト合成ツール(RVT)

◆ソリューション事業の拡大

➤半導体設計受託サービスを開始

➤EDAアウトソーシング・ビジネスを開始

◆九州デザインセンターの設立

➤福岡事業所、熊本事業所を開設

1. 平成27年3月期 第2四半期決算概要

2. 下期拡販戦略と今後の取り組み

3. 平成27年3月期通期予想

◆製品競争力の強化・拡販

➤ FPD/パワーデバイス分野向け拡販

✓ 解析系製品の強化・プロモーション

➤ FPD/半導体マスク検証向け拡販

✓ レイアウト・マスク検証系製品の投入

◆ソリューション事業の拡張

➤ EDAアウトソーシング・ビジネス分野の開拓

✓ 新ツールの投入(版管理, データ/負荷管理, 工程ドキュメント管理)

➤ 半導体設計受託サービスの本格始動→業容拡張

✓ 熊本事業所の開設、設計者の増員

◆ 海外市場向け売上拡大

➤ 販売力の強化

- ✓ 各国販売拠点・代理店の強化・再編(中国, 台湾, 米国)

➤ 新市場の開拓

- ✓ 半導体市場向け製品の投入(HOTSCOPE, SmartMRC etc.)

➤ 東アジア顧客向けサポート力の強化

- ✓ 福岡事業所の開設、本格稼働

1. 平成27年3月期 第2四半期決算概要

2. 下期拡販戦略と今後の取り組み

3. 平成27年3月期通期予想

国内半導体/FPD市場は先行き不透明な状況

海外市場は商談獲得時期の予測/制御が困難

ソリューション事業は順調に拡大する見通し

通期予想 — 前年同期比 —

(単位:百万円)	平成26年3月期 実績	平成27年3月期	
		期初計画	前年同期比
売上高	1,376	1,580	+14.8%
営業利益	79	120	+51.5%
経常利益	128	120	△6.6%
当期純利益	104	112	+7.0%

ご清聴ありがとうございました